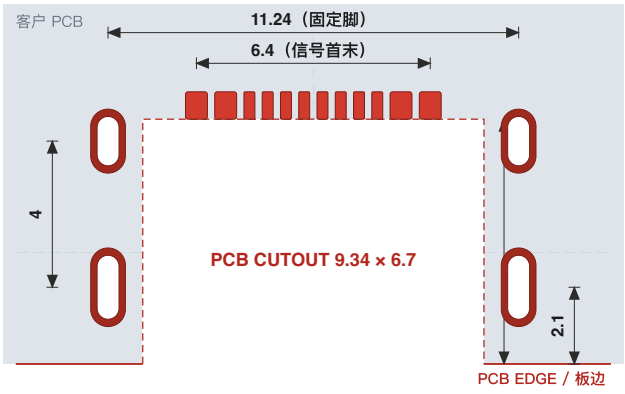
料号 PART NO.	封装 FOOTPRINT	类型 TYPE
CF16S16-4DS65Z3-002SN10	CF16S16-4DS65Z3-002SN10	沉板式 / 16P



1 mm · 俯视 · 单位 mm

灰底 = PCB / 红 = 焊盘 / 白孔 = PTH 金属化槽孔 / 红虚线圈 = NPTH 非金属化孔（不焊锡） / 红线 = 板边 / 红虚线 = U 形板挖空

关键尺寸

项目	数值 (mm)
信号焊盘 12 个	8×0.3×0.75 4×0.6×0.75
针距 / 首末距	0.5 / 0.65 / 0.8 / 6.4
固定脚焊盘 4 个	2×0.95×2.15 2×0.95×1.75
固定脚 槽孔（金属化）	2×1.75×0.6 2×1.35×0.6
固定脚间距	11.24 × 4
板边 → 前排脚中心	2.1
定位柱孔	无
焊盘层	Top（SMD）
三类孔	SMD 12 / PTH 4 / NPTH 0

安装要点

- **板上表面开下沉槽、母座向下沉**，不是在端口前方立一堵板；端口必须凸出板外，正前方不得有板材。挖空是**从板边开口的 U 形缺口**，放 Board Cutout 层，本款板挖空 **9.34 × 6.7 mm**（宽 × 深），**不能画成封闭的孔；缺口位于焊盘排外侧（端口方向），信号焊盘与 4 颗固定脚必须全部留在缺口之外的板面上，缺口内不布任何焊盘**；红色虚线是挖空轮廓，**不是丝印**。
- **上下两排固定脚槽长不一样**：本款槽孔 2×1.75×0.6 2×1.35×0.6、盘 2×0.95×2.15 2×0.95×1.75，别按卧式的等长槽套；固定脚穿孔锚定、孔壁镀铜、必须焊通。
- **三类孔**：**SMD 贴片焊盘**：仅顶层、无孔，SMT 回流焊；**PTH 金属化槽 / 孔**：孔壁镀铜、可插件焊接导通；**NPTH 非金属化孔**：钻孔打通、无铜，只给塑胶柱避位定位、不焊锡。
  本款**无 NPTH 孔**，不要自行给板厂单列定位孔；PTH 孔位按金属化处理、SMD 焊盘不钻孔。若在嘉立创 EDA 中另需 NPTH，请用「非金属化孔」图元、**不勾多层 / 金属化**。

常见问题

你会看到	实情
本款有塑胶定位柱吗?	没有。图纸 PCB 建议图未画定位柱孔，封装内也无 NPTH 开孔；不要自行给板厂单列 NPTH 钻孔。
红色虚线框是丝印吗 / 焊盘在框内吗	**不是丝印，焊盘也不在框内**。那是挖空轮廓（Board Cutout），U 形缺口从板边开口、位于焊盘排的端口一侧，框内是被铣掉的无板区；尺寸 9.34 × 6.7 mm，所有焊盘都在框外的板面上。板厂按此铣槽，不要把缺口画成封闭孔，更不要把焊盘圈进挖空里。
图上为什么没有元件外形线	沉板款的外形由**红色 U 形挖空**表达，不再叠画外形线，避免与挖空混淆；丝印以交付 PcbLib 为准。
固定脚只焊一侧行吗	**不行**。固定脚与外壳同网，须全部焊通以保证抗剥离。
SchLib 放置后要手动指定封装吗	要。符号库不预挂封装，请在属性里选 **CF16S16-4DS65Z3-002SN10**。
3D 预览里看不到孔	正常。3D 只显示产品本体，孔位与孔径以 2D 封装（PcbLib）与随附 PDF 图纸为准。

尺寸取自随附 PDF 图纸的 RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT 视图，并逐项与交付件 **CF16S16-4DS65Z3-002SN10.PcbLib** 核对：信号盘 8×0.3×0.75 4×0.6×0.75、针距 0.5 / 0.65 / 0.8、首末中心距 6.4、固定脚中心距 11.24×4、三类孔 SMD 12 / PTH 4 / NPTH 0。